

深圳长城开发科技股份有限公司 关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本项目回报周期较长，若受到行业周期不利影响，存储市场进入下行阶段，设备稼动率将随之下滑，固定资产折旧将加大，企业盈利水平承压，进而导致项目投资回收期会有所延长；

2、扩产后因为长期贷款增加，公司资产负债率预计提升 4%-5%，公司偿债压力增大；

3、本项目是基于公司产业布局及业务拓展的需要，存在因后续宏观经济、行业政策、市场环境及受到其它不可抗力因素影响等风险。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

为满足高端存储芯片封装测试市场增长需求，深化与战略客户合作，突破现有产能瓶颈，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沛顿科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳沛顿”）及控股子公司合肥沛顿存储科技有限公司（以下简称“合肥沛顿存储”）拟实施高端存储芯片封测产能扩充项目。项目计划总投资 14.70 亿元，用于购置高端芯片测试机、高精度晶圆研磨一体机等设备、厂房装修及配套动力设施等，项目建成达产后，深圳沛顿预计每月增加封装产能 500 万颗晶粒及测试产能 800 万颗芯片；合肥沛顿存储预计每月增加封装产能 2,880 万颗晶粒。

2026年5月26日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的议案》，该议案表决情况：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需经公司股东会批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

按照连续12个月累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型交易事项如下：

2025年11月6日公司同意深圳沛顿投资2.6亿元，扩大高端存储芯片封测产能，项目建成达产后，深圳沛顿预计每月增加UFS测试产能500万颗芯片及DDR测试产能426万颗芯片；同意合肥沛顿存储投资4.8亿元，扩大高端存储芯片封装产能，项目建成达产后，合肥沛顿存储预计每月增加封装产能1,780万颗晶粒。

二、企业基本情况及项目概况

（一）沛顿科技（深圳）有限公司

- 1、成立日期：2004年7月2日
- 2、注册地址：广东省深圳市福田区彩田路7006号
- 3、注册资本：17.48亿元人民币
- 4、股权结构：公司全资子公司，深科技100%持股
- 5、主营业务：高端存储芯片（DRAM、NAND FLASH）封装和测试服务
- 6、建设项目概况及方案

（1）项目名称：深圳沛顿产能扩充项目

(2) 项目建设地点：本项目在深圳沛顿现有厂区内建设，无需重新选址，厂区位于深圳市福田区彩田路 7006 号。

(3) 项目建设内容：约 1,200 平方米的改造、动力设施配套及新增封测设备约 185 台（套）。

(4) 项目建设周期：计划 2027 年 6 月建成

(5) 项目总投资估算：本项目总投资约 64,000 万元，其中封测设备投资 60,440 万元，建筑工程费 2,260 万元，工程建设其他费用及预备费 1,300 万元。

(6) 资金来源：62.5% 部分（即 40,000 万元）自筹，37.5%（即 24,000 万元）申请银行长期贷款。

(7) 经济效益：税前投资回收期 8.63 年。

(二) 合肥沛顿存储科技有限公司

1、成立日期：2020 年 10 月 30 日

2、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区萧山路 86 号

3、注册资本：30.60 亿元人民币

4、股权结构：公司控股子公司，深科技持股 55.88%，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股 31.05%，合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 9.80%，中电聚芯一号（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 3.27%。

5、主营业务：半导体器件和晶圆开发、设计、封装和测试及制造服务

6、建设项目概况及方案

(1) 项目名称：合肥沛顿存储封测产能扩大项目

(2) 项目建设地点：本项目在合肥沛顿存储现有厂房内进行建设，无需重新选址，厂区位于安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区萧山路 86 号。

(3) 项目建设内容：约 12,000 平方米装修及新增封测设备约 325 台(套)。

(4) 项目建设周期：计划 2027 年 12 月建成。

(5) 项目总投资估算：本项目总投资约 83,000 万元。

(6) 资金来源：20%部分(即 16,600 万元)自筹，80%(即 66,400 万元)申请银行长期贷款。

(7) 经济效益：税前投资回收期 8.84 年。

三、项目必要性分析

通过实施以上封测产能扩大项目，公司可积极响应客户的增量封装测试业务需求，提升客户黏性，进一步增强公司盈利能力，巩固公司半导体封测业务市场地位，进而实现封测业务稳步发展。

四、本项目对公司的影响

本项目属于公司主营业务范畴，公司已在生产、技术、管理和市场等方面积累成熟经验，项目的实施将进一步丰富公司产品结构、扩大生产规模、提升盈利水平，并与现有主业形成显著协同效应。项目实施后将有力增强企业在高端封测领域的核心竞争力和市场份额，助推实现可持续发展。

五、风险提示

本项目是基于公司产业布局及业务拓展的需要，如后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险，公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日